







### 目录

特性参数	2
亮度分档	2
显指分档	2
电压分档	2
色区分档	3
光电性能特征曲线	5
出货编码规则	6
产品尺寸	7
包装规格	8
回流焊曲线	10
注意事项	11

### 产品特征

规格: 3.5 mm×3.5 mm 垂直结构陶瓷封装 典型光通量(25℃) 350mA: 120lm

### 应用

城市亮化 商业照明 舞台灯光 智能家居 便携式照明



# 特性参数( $I_F = 350 \text{ mA}$ , $T_{solder pad} = 25^{\circ}\text{C}$ )

项目	单位	最小值	典型值	最大值
发光角度	degrees (°)		115	-
直流正向电流	mA		350	500
反向电压	V			5
正向电压	V	3.0	3.2	3.6
LED 结温	°C			150

### 亮度分档( $I_F = 350 \text{ mA}$ , $T_{\text{solder pad}} = 25^{\circ}\text{C}$ )

编号	最光通量范围(lm)	
Q4	100~107	
Q5	107~114	
R2	114~122	
R3	122~130	

备注: 亮度测试误差±7%

## 显指分档( $I_F = 350 \text{ mA}$ , $T_{\text{solder pad}} = 25^{\circ}\text{C}$ )

级别	范围	
В0	67~100	

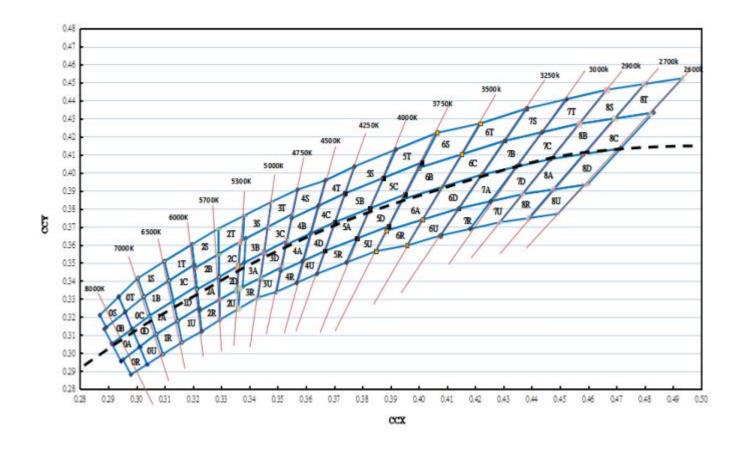
# 电压分档( $I_F = 350 \text{ mA}$ , $T_{\text{solder pad}} = 25^{\circ}\text{C}$ )

编号	电压范围(V)	
V2	3.0~3.2	
V3	3.2~3.4	
V4	3.4~3.6	

备注: 电压测试误差±0.1%



# 色区分档( $I_F = 350 \text{ mA}$ , $T_{solder pad} = 25^{\circ}\text{C}$ )



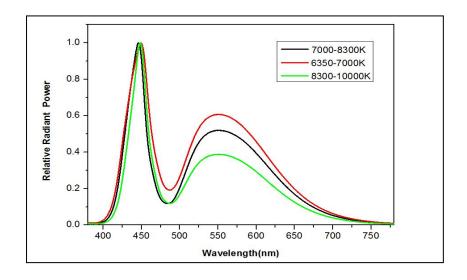


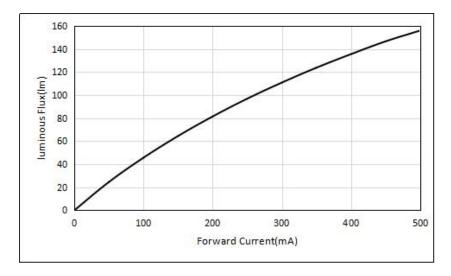
典型色温(K)	色度区域	
2600~2700	8T、8C、8D、8U	
2700~2900	8S、8B、8A、8R	
2900~3000	7T、7C、7D、7U	
3000~3250	7S、7B、7A、7R	
3250~3500	6T、6C、6D、6U	
3500~3750	6S、6B、6A、6R	
3750~4000	5T、5C、5D、5U	
4000~4250	5S、5B、5A、5R	
4250~4500	4T、4C、4D、4U	
4500~4750	4S、4B、4A、4R	
4750~5000	3T、3C、3D、3U	
5000~5300	3S、3A、3B、3R	
5300~5700	2T、2C、2D、2U	
5700~6000	2S、2B、2A、2R	
6000~6500	1T、1C、1D、1U	
6500~7000	1S、1A、1B、1R	
7000~8300	OA、OB、OC、OD、OR、OS、OT、OU	
8300~10000	WA、WK、WU	
10000~13000	GA	
13000 ~ 18000	GB	
18000 ~ 25000	GC	

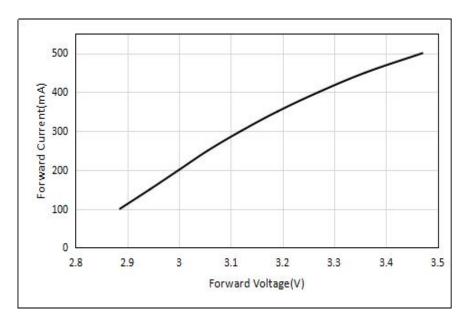
备注: 色区(CCx, CCy)尺寸误差±0.005



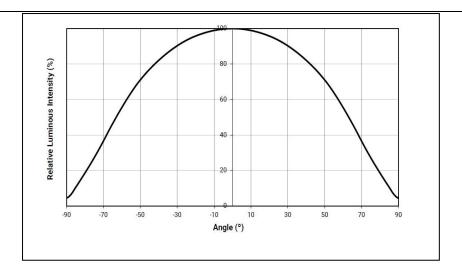
# 光电性能特征曲线( $I_F = 350 \text{ mA}$ , $T_{\text{solder pad}} = 25^{\circ}\text{C}$ )

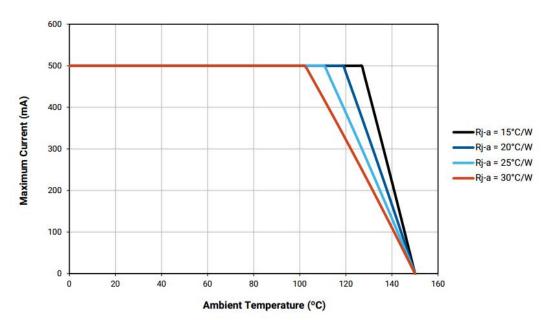






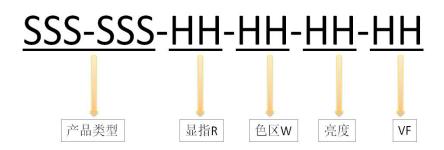






### 出货条码规则

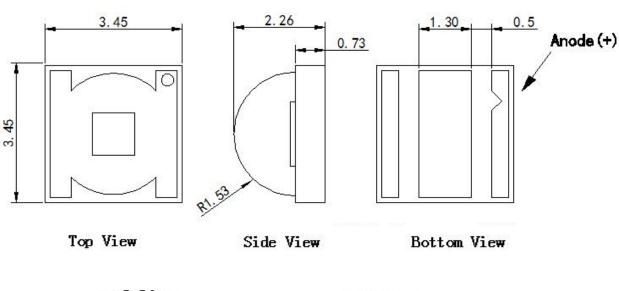
下图为产品编码规则

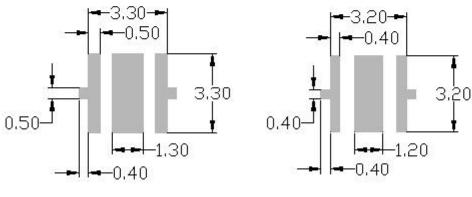


例如: LPCAWT-B0-WA-R2-V2, 其中 B0 表示显指; WA 表示色区,对应范围 8300-10000K; R2 表示亮度,对应范围 114~121.9lm; V2 表示正向电压,对应范围 3.0~3.2 V。

# 产品尺寸

单位: mm. 误差: ±0.05





Solder Pad

Stencil Pattern

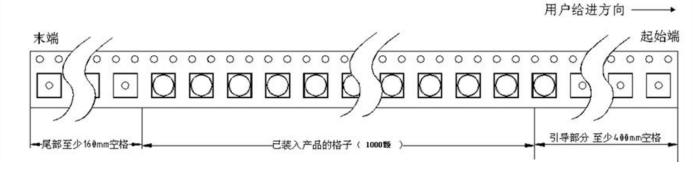
Rev.01

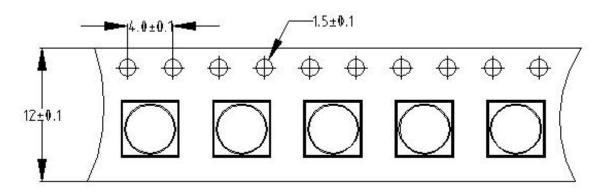
## 包装规格

包装方式: 7 英寸卷盘包装 (包装数量: 1000pcs)

单位: mm

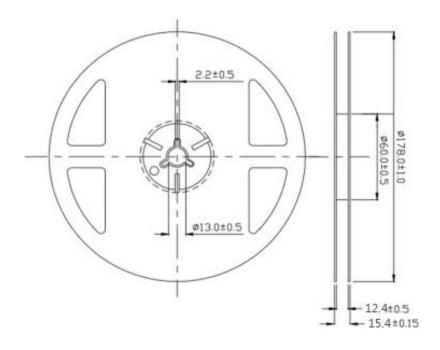
载带尺寸图



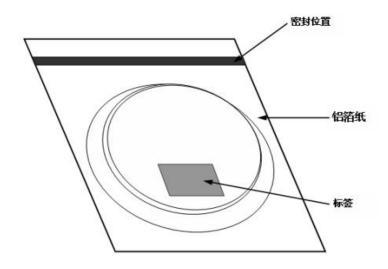


#### 卷盘尺寸图

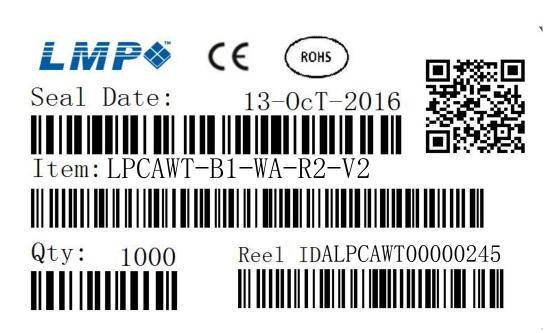
单位: mm



#### 防潮包装

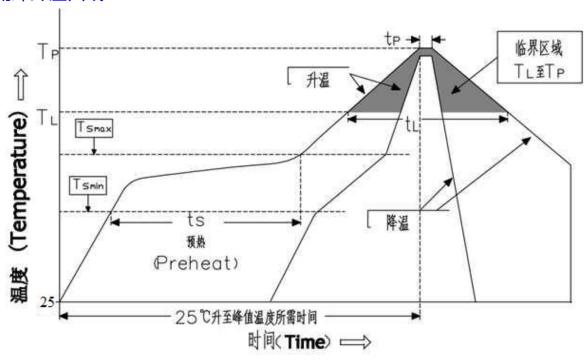


#### 出货条码





## 回流焊升温曲线



分布特征	含铅回流焊	无铅回流焊
平均升温速度(Ts <sub>max</sub> -T <sub>p</sub> )	3℃/second max.	3°C/second max.
最低预热温度(Tsmin)	100℃	150℃
最高预热温度(Ts <sub>max</sub> )	150℃	200℃
预热时间(tsmin-tsmax)	60~120 seconds	60~180 seconds
温度 ( T <sub>L</sub> )	183℃	217℃
维持在 TL以上的时间 (tL)	60~150 seconds	60~150 seconds
峰值温度(Tp)	215℃	260℃
维持与实际峰值温度相差在5°以内的时间(t <sub>p</sub> )	10~30 seconds	20~40 seconds
降温速度	6°C/second max.	6°C/second max.
从 25℃升至峰值温度所需时间	6 minutes max.	8 minutes max.

#### 备注:

- 1. 所有温度指封装表面温度,为封装体表面测定的数据;
- 2. 本回流焊曲线提供参考,并非适用于所有的 PCB 设计和回流焊设备;
- 3. 其他事项请参考《使用注意事项》。



### 使用注意事项

#### 一、储存

- 1. 储存温度 5~30℃,相对湿度小于 28%。
- 2. 避免外力破坏真空包装袋,以防受潮。

#### 二、 使用

- 1. 正品锡膏,标准自动贴片机贴装。
- 2. 八温区以上回流焊,峰值温度小于 260°C,时间小于 10s。
- 3. 重复回流焊不超过2次。
- 4. 杜绝对灯珠施力受压,以免透镜刮伤、变形或脱落,造成死灯。
- 5 禁止使用有机溶剂或超声波。
- 6.焊接面空洞率小于 20%。
- 7.冷却后方能测试及使用。
- 8.做好静电防护。